

2024-2030年中国芯片封测 行业发展态势与市场需求预测报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2024-2030年中国芯片封测行业发展态势与市场需求预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202310/412333.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

封装是指对通过测试的晶圆进行背面减薄（磨片）、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立具有完整功能的集成电路的过程。测试主要是对芯片、电路以及老化后的电路产品的功能、性能测试等，外观检测也归属于其中。目前，国内测试业务主要集中在封装企业中，通常统称为封装测试业（简称“封测业”）。

近年来，我国集成电路封装测试技术不断取得突破，本土封装测试企业已逐渐掌握了全球领先厂商的先进技术，如铜制程技术、BGA、PGA、WLP、MCM、MEMS、TSV、Bumping技术等，并且在应用方面也逐步成熟，部分先进封装产品已实现批量出货。国内封装技术与国际领先技术的差距越来越小，为推动我国封装测试行业继续做大做强奠定了牢固的基础。

2020年中国IC封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%。2021年，封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。企业运营方面，2021年中国本土封测公司前十名入围门槛为8亿元。2021年中国本土封测代工公司前十名出现两个新面孔-紫光宏茂和新汇成；分别来自于存储封装和驱动IC封装领域。2021年中国本土封测代工公司前十名合计营收为686亿元，较2020年增长31%。前十名中，只有沛顿出现下滑。增幅前三分别是宁波甬矽（167%）、华润安盛（144%）、紫光宏茂（115%）。

未来几年，芯片行业的整体增速将维持在30%以上。这是一个非常可观的增速，意味着行业规模不到3年就将翻一番。如此高速增长，芯片行业4大细分领域——设计、制造、封装、测试均将受益。

中企顾问网发布的《2024-2030年中国芯片封测行业发展态势与市场需求预测报告》共十二章。首先介绍了芯片封测行业相关概念以及国际发展形势，接着分析了中国芯片封测业发展环境及总体发展状况。随后，报告详细解析了先进封装技术的研发进展，并对不同类型的芯片封测市场、封测业上游市场以及区域市场的发展状况做了深度分析。然后，报告对芯片封测国内外重点企业经营情况进行了深入的分析，最后对芯片封测行业进行了投资价值评估及典型投资项目介绍，并对其未来发展前景做了科学的预测。

本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、工信部、商务部、财政部、中企顾问网、中企顾问网市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对芯片封测行业有个系统的了解或者想投资芯片封测相关产业，本报告是您不可或缺的重要工具。

报告目录：

第一章 芯片封测行业相关概述

- 1.1 半导体的定义和分类
 - 1.1.1 半导体的定义
 - 1.1.2 半导体的分类
 - 1.1.3 半导体的应用
- 1.2 半导体产业链分析
 - 1.2.1 半导体产业链结构
 - 1.2.2 半导体产业链流程
 - 1.2.3 半导体产业链转移
- 1.3 芯片封测相关介绍
 - 1.3.1 芯片封测概念界定
 - 1.3.2 芯片封装基本介绍
 - 1.3.3 芯片测试基本原理
 - 1.3.4 芯片测试主要分类
 - 1.3.5 芯片封测受益的逻辑

第二章 2021-2023年国际芯片封测行业发展状况及经验借鉴

- 2.1 全球芯片封测行业发展分析
 - 2.1.1 全球半导体市场发展现状
 - 2.1.2 全球芯片封测市场发展规模
 - 2.1.3 全球芯片封测市场区域布局
 - 2.1.4 全球芯片封测市场竞争格局
 - 2.1.5 全球封装技术发展现状分析
 - 2.1.6 全球封测产业驱动力分析
- 2.2 日本芯片封测行业发展分析
 - 2.2.1 政府资金扶持半导体
 - 2.2.2 半导体市场发展规模
 - 2.2.3 芯片封测企业发展状况
 - 2.2.4 芯片封测发展经验借鉴
- 2.3 中国台湾芯片封测行业发展分析
 - 2.3.1 芯片封测市场规模分析
 - 2.3.2 芯片封测企业盈利状况
 - 2.3.3 芯片封装技术研发进展

2.3.4 芯片市场发展经验借鉴

2.4 其他国家芯片封测行业发展分析

2.4.1 美国

2.4.2 韩国

2.4.3 新加坡

第三章 2021-2023年中国芯片封测行业发展环境分析

3.1 政策环境

3.1.1 智能制造推动政策

3.1.2 集成电路相关政策

3.1.3 中国制造支持政策

3.1.4 产业投资基金支持

3.2 经济环境

3.2.1 宏观经济概况

3.2.2 工业经济运行

3.2.3 对外经济分析

3.2.4 固定资产投资

3.2.5 宏观经济展望

3.3 社会环境

3.3.1 互联网运行状况

3.3.2 电子信息产业收入

3.3.3 电子信息产业增速

3.3.4 研发经费投入增长

3.4 产业环境

3.4.1 集成电路产业链

3.4.2 产业销售规模

3.4.3 产品产量规模

3.4.4 区域分布情况

3.4.5 市场贸易状况

第四章 2021-2023年中国芯片封测行业发展全面分析

4.1 中国芯片封测行业发展综述

- 4.1.1 行业主管部门
- 4.1.2 行业发展特征
- 4.1.3 行业发展规律
- 4.1.4 主要上下游行业
- 4.1.5 制约因素分析
- 4.1.6 行业利润空间
- 4.2 2021-2023年中国芯片封测行业运行状况
 - 4.2.1 市场规模分析
 - 4.2.2 主要产品分析
 - 4.2.3 企业类型分析
 - 4.2.4 企业市场份额
 - 4.2.5 区域分布占比
- 4.3 中国IC封装测试行业上市公司运行状况分析
 - 4.3.1 上市公司规模
 - 4.3.2 上市公司分布
 - 4.3.3 经营状况分析
 - 4.3.4 盈利能力分析
 - 4.3.5 营运能力分析
 - 4.3.6 成长能力分析
 - 4.3.7 现金流量分析
- 4.4 中国芯片封测行业技术分析
 - 4.4.1 技术发展阶段
 - 4.4.2 行业技术水平
 - 4.4.3 产品技术特点
- 4.5 中国芯片封测行业竞争状况分析
 - 4.5.1 行业重要地位
 - 4.5.2 国内市场优势
 - 4.5.3 核心竞争要素
 - 4.5.4 行业竞争格局
 - 4.5.5 竞争力提升策略
- 4.6 中国芯片封测行业协同创新发展模式分析
 - 4.6.1 华进模式

- 4.6.2 中芯长电模式
- 4.6.3 协同设计模式
- 4.6.4 联合体模式
- 4.6.5 产学研用协同模式

第五章 2021-2023年中国先进封装技术发展分析

- 5.1 先进封装基本介绍
 - 5.1.1 先进封装基本含义
 - 5.1.2 先进封装发展阶段
 - 5.1.3 先进封装系列平台
 - 5.1.4 先进封装影响意义
 - 5.1.5 先进封装发展优势
 - 5.1.6 先进封装技术类型
 - 5.1.7 先进封装技术特点
- 5.2 中国先进封装技术市场发展现状
 - 5.2.1 先进封装市场发展规模
 - 5.2.2 先进封装技术占比情况
 - 5.2.3 先进封装产能布局情况
 - 5.2.4 先进封装技术竞争情况
 - 5.2.5 先进封装市场布局情况
 - 5.2.6 先进封装技术应用领域
 - 5.2.7 先进封装行业收入情况
- 5.3 先进封装技术分析
 - 5.3.1 堆叠封装
 - 5.3.2 晶圆级封装
 - 5.3.3 2.5D/3D技术
 - 5.3.4 系统级封装SiP技术
- 5.4 先进封装技术未来发展空间预测
 - 5.4.1 先进封装技术趋势
 - 5.4.2 先进封装规模预测
 - 5.4.3 先进封装发展动能
 - 5.4.4 先进封装发展战略

第六章 2021-2023年中国芯片封测行业不同类型市场发展分析

6.1 存储芯片封测行业

6.1.1 行业发展背景

6.1.2 行业发展现状

6.1.3 企业项目动态

6.1.4 典型企业发展

6.2 逻辑芯片封测行业

6.2.1 行业基本介绍

6.2.2 行业发展现状

6.2.3 行业技术创新

6.2.4 典型企业布局

第七章 2021-2023年中国芯片封测行业上游市场发展分析

7.1 2021-2023年封装测试材料市场发展分析

7.1.1 封装材料市场基本介绍

7.1.2 全球封测材料市场规模

7.1.3 中国台湾封装材料市场动态

7.1.4 中国大陆封装材料市场规模

7.2 2021-2023年封装测试设备市场发展分析

7.2.1 封装测试设备主要类型

7.2.2 全球封测设备市场规模

7.2.3 封装设备市场结构分布

7.2.4 封装设备企业竞争格局

7.2.5 封装设备国产化率分析

7.2.6 封装设备促进因素分析

7.2.7 封测设备市场发展前景

7.3 2021-2023年中国芯片封测材料及设备进出口分析

7.3.1 塑封树脂

7.3.2 自动贴片机

7.3.3 塑封机

7.3.4 引线键合装置

7.3.5 测试仪器及装置

7.3.6 其他装配封装机器及装置

第八章 2021-2023年中国芯片封测行业部分区域发展状况分析

8.1 深圳市

8.1.1 政策环境分析

8.1.2 产业发展现状

8.1.3 企业发展现状

8.1.4 产业发展问题

8.1.5 产业发展对策

8.2 江西省

8.2.1 政策环境分析

8.2.2 产业发展现状

8.2.3 企业发展情况

8.2.4 项目落地状况

8.2.5 产业发展问题

8.2.6 产业发展对策

8.3 上海市

8.3.1 产业政策环境

8.3.2 产业发展现状

8.3.3 企业发展情况

8.3.4 产业园区发展

8.3.5 行业发展不足

8.3.6 行业发展对策

8.4 苏州市

8.4.1 产业政策环境

8.4.2 产业发展现状

8.4.3 企业发展状况

8.4.4 产业园区建设

8.4.5 项目建设动态

8.4.6 未来发展方向

8.5 徐州市

- 8.5.1 政策环境分析
- 8.5.2 产业发展现状
- 8.5.3 产业园区建设
- 8.5.4 项目建设动态
- 8.6 无锡市
 - 8.6.1 产业发展历程
 - 8.6.2 政策环境分析
 - 8.6.3 产业发展情况
 - 8.6.4 企业发展情况
 - 8.6.5 区域发展现状
 - 8.6.6 项目落地状况
 - 8.6.7 产业创新中心
- 8.7 其他地区
 - 8.7.1 北京市
 - 8.7.2 天津市
 - 8.7.3 合肥市
 - 8.7.4 成都市
 - 8.7.5 西安市
 - 8.7.6 重庆市
 - 8.7.7 杭州市
 - 8.7.8 南京市

第九章 2020-2023年国内外芯片封测行业重点企业经营状况分析

- 9.1 艾马克技术公司 (Amkor Technology, Inc.)
 - 9.1.1 企业发展概况
 - 9.1.2 2021年企业经营状况分析
 - 9.1.3 2022年企业经营状况分析
 - 9.1.4 2023年企业经营状况分析
- 9.2 日月光半导体制造股份有限公司
 - 9.2.1 企业发展概况
 - 9.2.2 2021年企业经营状况分析
 - 9.2.3 2022年企业经营状况分析

- 9.2.4 2023年企业经营状况分析
- 9.3 京元电子股份有限公司
 - 9.3.1 企业发展概况
 - 9.3.2 2021年企业经营状况分析
 - 9.3.3 2022年企业经营状况分析
 - 9.3.4 2023年企业经营状况分析
- 9.4 江苏长电科技股份有限公司
 - 9.4.1 企业发展概况
 - 9.4.2 经营效益分析
 - 9.4.3 业务经营分析
 - 9.4.4 财务状况分析
 - 9.4.5 核心竞争力分析
 - 9.4.6 公司发展战略
 - 9.4.7 未来前景展望
- 9.5 天水华天科技股份有限公司
 - 9.5.1 企业发展概况
 - 9.5.2 经营效益分析
 - 9.5.3 业务经营分析
 - 9.5.4 财务状况分析
 - 9.5.5 核心竞争力分析
 - 9.5.6 公司发展战略
 - 9.5.7 未来前景展望
- 9.6 通富微电子股份有限公司
 - 9.6.1 企业发展概况
 - 9.6.2 经营效益分析
 - 9.6.3 业务经营分析
 - 9.6.4 财务状况分析
 - 9.6.5 核心竞争力分析
 - 9.6.6 公司发展战略
 - 9.6.7 未来前景展望
- 9.7 苏州晶方半导体科技股份有限公司
 - 9.7.1 企业发展概况

- 9.7.2 经营效益分析
- 9.7.3 业务经营分析
- 9.7.4 财务状况分析
- 9.7.5 核心竞争力分析
- 9.7.6 公司发展战略
- 9.7.7 未来前景展望
- 9.8 广东利扬芯片测试股份有限公司
- 9.8.1 企业发展概况
- 9.8.2 经营效益分析
- 9.8.3 业务经营分析
- 9.8.4 财务状况分析
- 9.8.5 核心竞争力分析
- 9.8.6 公司发展战略
- 9.8.7 未来前景展望

第十章 对中国芯片封测行业的投资分析

- 10.1 上市公司在半导体行业投资动态分析
 - 10.1.1 投资项目综述
 - 10.1.2 投资区域分布
 - 10.1.3 投资模式分析
 - 10.1.4 投资模式分析
 - 10.1.5 典型投资案例
- 10.2 芯片封测行业投资背景分析
 - 10.2.1 行业投资现状
 - 10.2.2 行业投资前景
 - 10.2.3 行业投资机会
- 10.3 芯片封测行业投资壁垒
 - 10.3.1 技术壁垒
 - 10.3.2 资金壁垒
 - 10.3.3 生产管理经验壁垒
 - 10.3.4 客户壁垒
 - 10.3.5 人才壁垒

- 10.3.6 认证壁垒
- 10.4 芯片封测行业投资风险
 - 10.4.1 市场竞争风险
 - 10.4.2 技术进步风险
 - 10.4.3 人才流失风险
 - 10.4.4 所得税优惠风险
 - 10.4.5 其他投资风险
- 10.5 芯片封测行业投资建议
 - 10.5.1 行业投资建议
 - 10.5.2 行业竞争策略

第十一章 中国芯片封测产业典型项目投资建设案例深度解析

- 11.1 芯片测试产能建设项目
 - 11.1.1 项目基本概述
 - 11.1.2 项目投资价值
 - 11.1.3 项目投资概算
 - 11.1.4 项目实施进度
- 11.2 存储先进封测与模组制造项目
 - 11.2.1 项目基本概述
 - 11.2.2 项目必要性分析
 - 11.2.3 项目可行性分析
 - 11.2.4 项目投资概算
 - 11.2.5 经济效益估算
- 11.3 华润微功率半导体封测基地项目
 - 11.3.1 项目基本概述
 - 11.3.2 项目必要性分析
 - 11.3.3 项目可行性分析
 - 11.3.4 项目投资主体
- 11.4 华天科技芯片封测项目
 - 11.4.1 项目资金计划
 - 11.4.2 项目基本概述
 - 11.4.3 项目必要性分析

- 11.4.4 经济效益分析
- 11.5 第三代半导体SiC/GaN功率器件及封测的研发项目
 - 11.5.1 项目基本概述
 - 11.5.2 项目投资概算
 - 11.5.3 项目必要性分析
 - 11.5.4 项目可行性分析
 - 11.5.5 经济效益估算

第十二章 对2024-2030年中国芯片封测行业发展前景及趋势预测分析

- 12.1 中国芯片封测行业发展前景展望
 - 12.1.1 半导体市场前景展望
 - 12.1.2 芯片封测行业发展机遇
 - 12.1.3 芯片封测企业发展前景
 - 12.1.4 芯片封装领域需求提升
 - 12.1.5 终端应用领域的带动
- 12.2 中国芯片封测行业发展趋势分析
 - 12.2.1 封测企业发展趋势
 - 12.2.2 封装行业发展方向
 - 12.2.3 封装技术发展趋势
- 12.3 对2024-2030年中国芯片封测行业预测分析
 - 12.3.1 2024-2030年中国芯片封测行业影响因素分析
 - 12.3.2 2024-2030年中国芯片封装测试业销售规模预测

图表目录

- 图表 半导体分类结构图
- 图表 半导体分类
- 图表 半导体分类及应用
- 图表 半导体产业链示意图
- 图表 半导体上下游产业链
- 图表 半导体产业转移和产业分工
- 图表 集成电路产业转移状况
- 图表 全球主要半导体厂商

图表 现代电子封装包含的四个层次

图表 根据封装材料分类

图表 目前主流市场的两种封装形式

图表 2021年全球半导体销售额统计

图表 2020年全球封测行业市场规模变化趋势

图表 2019年全球IC封测市场区域分布

图表 2021年全球前十大封测业者营收排名

图表 全球集成电路封装行业技术周期

图表 2010-2021年全球集成电路封装行业专利申请量及授权量情况

图表 2021年全球集成电路封装行业专利法律状态

图表 截止2021年全球集成电路封装行业专利市场总价值及专利价值分布情况

图表 截止2021年全球集成电路封装行业专利类型

图表 2021年全球集成电路封装行业热门技术词

图表 截止2021年全球集成电路封装行业被引用次数top10专利

图表 截止2021年全球集成电路封装行业技术来源国分布情况

图表 截止2021年中国当前申请省（市、自治区）集成电路封装专利数量top10

图表 截止2021年全球集成电路封装行业专利申请数量top10申请人

图表 2017-2020年中国台湾IC产业产值

图表 “中国制造2025”的重点领域与战略目标

图表 “中国制造2025”政策推进时间表

图表 《中国制造2025》半导体产业政策目标

图表 国家集成电路产业基金投资方向

图表 2020年GDP最终核实数与初步核算数对比

图表 2021年四季度和全年GDP初步核算数据

图表 2016-2021年GDP同比增长速度

图表 2016-2021年GDP环比增长速度

图表 2019-2020年中国规模以上工业增加值同比增长速度

图表 2020年中国规模以上工业生产主要数据

图表 2020-2021年规模以上工业增加值同比增长速度

图表 2021年规模以上工业生产主要数据

图表 2016-2020年货物进出口总额

图表 2020年货物进出口总额及其增长速度

- 图表 2020年主要商品出口数量、金额及其增长速度
- 图表 2020年主要商品进口数量、金额及其增长速度
- 图表 2020年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
- 图表 2020年外商直接投资（不含银行、证券、保险领域）及其增长速度
- 图表 2020年对外非金融类直接投资额及其增长速度
- 图表 2020年三次产业投资占固定资产投资（不含农户）比重
- 图表 2020年分行业固定资产投资（不含农户）增长速度
- 图表 2020年固定资产投资新增主要生产与运营能力
- 图表 2020-2021年固定资产投资（不含农户）同比增速
- 图表 2021年固定资产投资（不含农户）主要数据
- 图表 2012-2021年电子信息制造业和工业企业利润总额增速情况
- 图表 2012-2021年电子信息制造业和工业增加值增速情况
- 图表 2020-2021年电子信息制造业和工业增加值分月增速情况
- 图表 2012-2021年电子信息制造业和工业企业出口交货值增速情况
- 图表 2012-2021年电子信息制造业和制造业固定资产投资增速情况
- 图表 2017-2021年研究与试验发展（R&D）经费支出及其增长速度

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202310/412333.html>